公司代码:688126 公司简称:沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2026 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。经审计,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为 63,847,574.92 元;2025 年度,公司归属于上市公司股东的净利润为 -1,507,506,599.58 元。经审慎考虑,公司 2025 年度不实施现金分红,不以资本公积转增股本,不送红股。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方娜	王艳
联系地址	中国上海(自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号	中国上海(自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
电话	021-52589038	021-52589038
传真	021-52589196	021-52589196
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料,是半导体产业链基础性的一环。公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一,多年来深耕半导体基础材料领域,主营业务聚焦于半导体硅片及其他高端半导体材料的研发、生产与销售,为下游芯片制造企业提供关键核心材料,是半导体产业链中不可或缺的基础性环节。公司始终将扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为核心发展战略,持续推进技术突破与产能扩张,助力国内半导体产业链自主可控。

公司现已构建起全尺寸、全品类的半导体硅片产品矩阵,覆盖 300mm、200mm 及以下等尺寸,涵盖抛光片、外延片、SOI 硅片等品类,同时布局压电薄膜衬底材料等异质晶圆特色产品,广泛应用于存储、逻辑、硅光、图像处理、通用处理器、功率、射频、模拟、分立等芯片制造,全面满足下游不同领域的应用需求。

公司构建了全球化、多元化的客户体系,覆盖国际一流与国内主流芯片制造企业。国际客户包括台积电、联电、意法半导体、威世等全球头部芯片厂商,国内客户涵盖中芯国际、华虹宏力、华润微等主要芯片制造企业,产品远销北美、欧洲、中国大陆、亚洲其他国家及地区,技术与产品获得全球头部客户高度认可。未来,公司将持续聚焦产能扩张与产品高端化,深耕 AI 芯片、汽车电子、硅光等新兴领域,深化全球化布局,致力于打造具有国际竞争力的半导体硅片企业,为国内半导体产业高质量发展提供有力支撑。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司核心业务为半导体硅片的研发、生产与销售,盈利主要来源于向下游芯片制造企业销售各类半导体硅片产品。公司依托全尺寸、全品类的产品矩阵,通过规模化生产、技术升级优化成本结构,尽管受行业周期性影响和价格承压导致亏损,但随着全球化客户布局的拓展、以及收入的稳定提升,公司的长期、持续发展基础将得以夯实。

2、采购模式

为保障公司产品质量与性能稳定,契合半导体硅片高纯度、高精度的行业要求,公司严格制定供应商选择、审核及动态管理体系,建立了完善的合格供应商名录管理制度。供应商需全面满足经营资质、研发设计能力、技术水平、质量管控体系、生产能力、产品性价比、交货周期及付款周期等多维度标准,经严格审核后方可纳入公司合格供应商名录,且公司会对名录内供应商开展定期审核与动态评估,持续优化供应商结构。截至 2025 年末,公司已与全球范围内众多优质供应商建立长期、稳定的战略合作关系,保障原材料、生产设备、零部件等核心采购产品的稳定供应,为公司产能扩张与产品品质提升提供坚实支撑。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,结合下游客户订单需求,统筹安排批量生产计划,同时根据市场需求预测、产品迭代周期及客户交付周期,进行少量备货式生产,平衡订单交付效率与库存合理水平,更好地匹配和满足客户的备货需求。在生产管理方面,公司建立了标准化、精细化的生产管理制度,对生产全流程的人员、设备、工艺、质量等关键因素进行严格管控、合理调配生产资源、协调各项生产活动,确保产品质量与交付时效全面满足行业标准及客户个性化需求。生产布局上,公司以自主生产为核心,同时结合市场需求波动和自身产能利用情况,在部分非关键性技术生产环节适当采用外协加工模式作为补充,以最大化释放产能潜力、满足市场需求。

4、销售模式

半导体硅片行业壁垒高、市场集中度高,生产企业与主要下游客户均较为集中,基于行业特性,公司主要采用直接销售模式。针对国内外头部芯片制造企业等主要客户,公司采取主动开发、一对一直接谈判的方式对接需求、获取订单,建立长期稳定的合作关系,保障核心营收规模;针对中小客户及部分区域市场,公司通过少量专业代理商协助开展客户接洽、订单跟进等工作,拓宽客户覆盖范围,优化客户结构。2025 年公司产品远销北美、欧洲、中国大陆及亚洲其他国家和地区,全球化销售布局持续完善,进一步提升了市场抗风险能力。

5、研发模式

公司深度践行“产、学、研一体化”研发模式,始终坚持技术创新驱动发展,2025 年研发投入约 3.54 亿元,研发投入占营业收入比例提升至 9.52%,较 2024 年显著提升。公司持续深化与国内顶尖教学科研机构的紧密合作,聚焦产业实际需求开展技术研发,在提升自身核心技术能力的同时,助力中国半导体硅片行业整体技术进步与科研水平提升。在研发方向上,公司将重点加大核心产品相关技术研发投入,聚焦单晶生长、切割、研磨、抛光、外延与 SOI 等技术领域,特别加强面向射频、硅光、高压等应用的 300mm SOI 技术研发与工艺优化,持续追赶国际先进水平,同时推进高端产品产业化进程,为公司长期发展筑牢技术壁垒。

2.3 所处行业情况

(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

长期以来,半导体行业受下游需求波动、技术迭代周期等因素影响,呈现周期性波动与长期上涨并存的发展态势,半导体硅片作为产业链上游核心基础材料,其行业周期受到半导体整体行业周期的直接影响。根据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2016 年至 2025 年间,全球半导体硅片(含 SOI)销售额从 76.5 亿美元上升至 126.5 亿美元,年均复合增长率达 5.75%。2025 年,全球半导体市场延续增长态势,AI 应用及数据中心基础设施需求成为核心增长动力,但消费类电子、工业电子等传统应用领域仍处于疲软状态,呈现同比微跌趋势,行业复苏呈现明显的结构性分化特征。根据 SEMI 旗下的 Silicon Manufacturers Group(SMG)发布的硅片行业年终分析报告显示,2025 年全球半导体硅片出货面积增长 5.8%,达到 12,973 百万平方英寸(million square inch,MSI),而同期整体销售额同比下滑约 1.2%。尽管受 AI 应用驱动,用于先进逻辑芯片的外延片和用于高带宽存储(HBM)的抛光片需求强劲,推动半导体硅片出货面积恢复增长。但传统半导体应用增长乏力,其需求和价格环境尚未显著改善。

从行业所处阶段来看,全球半导体硅片行业正处于周期筑底、结构升级的关键时期,国内市场依托下游芯片制造企业扩产红利及国产替代加速趋势,仍处于快速发展的成长期,叠加 AI、汽车电子、硅光等新兴领域的长期需求拉动,行业长期增长空间广阔。

(2)行业发展的基本特点

半导体硅片行业整体呈现三大核心基本特点:

一是周期性与结构性分化并存,行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势,半导体硅片行业的市场波动与整个半导体行业周期基本同步,同时 2025 年行业呈现明显的结构性分化——AI 应用及算力相关先进制程领域需求旺盛,传统应用领域复苏乏力,这一特征使得不同尺寸、不同类型、面向不同制程应用的半导体硅片市场需求呈现一定差异化。

二是“后摩尔定律时代”下,技术升级与产能扩张成为行业发展的主线。全球半导体产业已进入“后摩尔定律时代”,2nm 制程逐步量产,GAA(Gate-All-Around,环绕栅极)架构广泛应用,芯片制程向更先进节点迭代的同时,特种工艺持续创新,市场需求长期呈增长态势;同时,根据 SEMI 预测,到 2028 年,全球预计将新建 108 座晶圆厂,其中亚洲 84 座,中国独占 47 座,超过亚洲新增产能的一半;而在 22 至 40 纳米主流制程节点,中国产能占比将从 2024 年的 25%提升至 2028 年的 42%。下游产能扩张将持续拉动硅片需求,因此同步推进产能扩充与技术升级,成为产业链各环节企业应对市场挑战、抢占发展先机的核心举措。

三是全球产能扩张与国产替代并行推进,尽管目前国际主要半导体硅片企业均已启动扩产计划,但叠加各国对半导体供应链安全的重视及技术出口管制收紧,国内半导体硅片行业仍将迎来重要发展机遇。2025 年,国内半导体硅片行业特别是 300mm 半导体硅片业务呈现“国产化加速、结构升级、技术攻坚”的关键特征,本土客户加速推进国产供应商认证,国产替代从“单点突破”向“全面开花”演进,公司作为国内龙头企业,也依托这一趋势实现营收稳步增长。

(3)主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键核心原材料,属于典型的技术密集、人才密集型行业,行业技术门槛较高,核心技术壁垒主要体现在工艺精度与质量稳定控制和全流程技术整合两大方面,这一特征在 2025 年公司技术迭代中极为凸显。

从技术要求来看,下游芯片制造采用不同的工艺制程,对应不同的特征尺寸和最小线宽,随着半导体制程进入 2nm 时代,先进工艺和特种工艺技术对半导体硅片的晶体原生缺陷、杂质控制水平、硅片表面及边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等核心技术指标提出了更为严苛的要求。芯片制程技术节点越先进、特征尺寸越小,对半导体硅片各项指标的控制标准越严苛,不同技术节点对应的指标控制参数甚至相差几个数量级,对生产工艺的精细化程度和质量稳定要求极高。

作为国内半导体硅片龙头企业,公司始终坚持技术研发投入,2025 年持续加大核心产品相关技术研发力度,研发投入规模和占收入比例持续提高,已全面突破行业核心技术门槛,有力支撑了公司经营发展。公司掌握了半导体硅片生产全流程的多项核心技术,涵盖 300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片相关的直拉单晶生长、磁场直拉单晶生长、热场模拟和设计、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐蚀、双面研磨、边缘研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光、硅片清洗、外延等技术,以及 SOI 制备技术。其中,公司已全面突破了 300mm 近完美单晶生长、超平坦抛光工艺以及极限表征等关键技术瓶颈,并建立了具有国际化水平的 300mm 硅材料极限表征体系,强有力支撑了研发工作的快速迭代,保障了公司半导体硅片产品质量与国际先进水平的同步提升,也为公司 300mm 半导体硅片产能扩张、高端产品产业化提供了坚实技术支撑。

(2).公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体硅片行业具有典型的寡头垄断格局,长期以来全球市场均被全球前五大硅片厂商牢牢掌控,分别为日本信越化学、日本 SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国 Siltronic 及韩国 SK Siltron。当前,上述五家企业合计占据了全球 80%以上的市场份额,形成了技术、产能、客户资源的多重壁垒,尤其在 300mm 高端硅片领域,长期垄断核心供给,主导行业技术迭代节奏与市场定价,后发企业的市场空间,特别是海外市场空间受到挤压。尽管近年来全球半导体硅片行业出现周期性波动,部分细分领域面临价格承压与库存消化压力,但五大龙头的垄断格局尚未出现根本性改变,行业准入门槛依旧显高不下。

公司作为国内领先的半导体硅片企业之一,自成立以来,始终以全球前五大硅片厂商为长远发展目标,依托持续的技术研发与产能扩张,实现业务快速突破,行业地位稳步提升,成为国内半导体硅片领域打破国际垄断、推动国产替代的核心力量,其行业地位及变化主要体现在国内领先与国际追赶两大维度。作为国内领先的半导体硅片企业,公司始终将扩大生产规模、丰富产品结构、持续提高市场占有率作为核心战略任务,同步推进技术升级与产能扩充,逐步缩小与全球龙头的差距。报告期内,公司各子公司分别启动多项重点建设项目,聚焦 300mm 及 200mm 半导体硅片的技术能力提升与产能扩容,并持续突破高端产品瓶颈,在 300mm SOI 硅片领域取得阶段性突破,主要产品已完成关键技术研发,进入量产落地与市场验证阶段。

在保持国内领先地位的基础上,公司正加速开拓国际市场,提升国际综合竞争力。当前,受益于国内下游芯片制造企业扩产红利、国产替代加速趋势,以及 AI、汽车电子、硅光等新兴领域的需求拉动,公司凭借稳定的产品质量、完善的产品矩阵,加速进入国际市场。同时,公司通过子公司 Okmetic 深耕高端利基市场,进一步完善全球化布局,逐步实现从“国内龙头”向“全球参与者”的转型,行业地位持续提升,成为全球半导体硅片行业中不可忽视的中国力量。

(3).报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,半导体行业在 AI 需求爆发、国产替代加速、新兴应用渗透的多重驱动下,呈现“结构性景气”特征,行业整体景气度上行但细分领域分化明显。半导体硅片作为产业链核心基础材料,紧跟行业发展步伐,未来发展趋势与全球技术迭代、国内产业需求深度绑定。

半导体行业新技术核心聚焦于先进制程迭代与特种工艺创新,工艺制程持续微缩,推动半导体硅片技术向更高精度、更低缺陷、更优性能升级。随着半导体制程不断缩小,芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度持续降低,对应在半导体硅片制造过程中,对硅片表面平坦度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标的控制要求愈发严苛,这些参数直接决定半导体产品的成品率和性能。报告期内,半导体及半导体硅片行业技术均呈现“双轨并行”趋势:一是持续沿着摩尔定律向更先进的工艺制程突破,聚焦硅片极限精度控制、杂质去除、翘曲度优化等核心技术,满足 AI 高算力芯片、高端存储芯片的需求;二是特种工艺与材料技术持续创新,SOI 硅片、压电薄膜材料等异质集成技术不断升级,适配车规级、工业级高端应用场景;同时,成熟制程技术将持续优化,面向 28nm 及以上技术节点应用的半导体硅片将通过工艺改进提升性价比,适配射频器件、传感器、功率器件等海量应用需求,形成“先进制程引领、成熟制程支撑”的技术发展格局。

报告期内,半导体行业新产业布局聚焦于 AI 算力、汽车电子、光互连、AR 等新兴领域,形成多赛道协同发展的产业格局,半导体硅片作为核心基础材料,产业需求呈现结构性分化与增量突破并存的特征。从细分领域来看,AI 大模型商业化加速落地,算力需求呈指数级增长,带动高端存储、先进逻辑芯片需求爆发,进而拉动 300mm 高端硅片、外延片及存储用抛光片需求持续攀升,成为半导体硅片产业增长的核心引擎;新能源汽车市场持续升温,车规级芯片需求日益增长,面向车规级驱动芯片、电源管理芯片、IGBT、功率器件、图像传感器、MCU 等应用的特殊规格产品迎来更为广阔的市场空间。此外,国内半导体产业链自主可控进程加速,下游芯片制造企业持续扩产,进一步拉动半导体硅片产业产能扩张与产品升级。未来,半导体硅片产业将持续围绕新兴应用场景拓展,形成“高端化、多元化、国产化”发展趋势:AI 应用、汽车电子、光通信等新兴领域将持续释放需求,带动 300mm 高端硅片、SOI 硅片等产品产能扩容;国产替代持续深化,以公司为代表的国内半导体硅片企业将逐步实现从成熟制程到先进制程的全面突破;产业协同进一步加强,形成从半导体硅片材料、芯片制造到终端应用的全产业链生态,推动产业整体竞争力提升。

报告期内,半导体及半导体硅片行业新业态主要体现为“结构性景气”凸显、全球化布局与区域化协同并行的特征。行业不再“普涨普跌”,而是呈现明显的分化态势:与 AI 算力、存储直接相关的硅片细分领域需求旺盛,而依赖传统消费电子需求的硅片领域则呈现温和复苏态势,AI、汽车电子、硅光等新兴领域持续主导需求增长,将推动硅片产品结构向高端化倾斜;此外,行业新业态还体现在“专业化分工与协同创新”深化,半导体硅片企业与下游芯片制造企业、上游设备供应商、科研机构的协同愈发紧密,形成“研发 – 生产 – 应用”闭环,协同创新成为核心发展业态。未来,公司将加强与产业链上下游的深度合作,聚焦场景化需求开展定制化研发,同时深化“产、学、研一体化”模式,推动技术快速迭代。

报告期内,半导体硅片行业新模式主要聚焦于“定制化服务、智能化生产、全球化运营、生态化布局”四大方向,适配行业结构性变化与产业升级需求。在定制化服务方面,随着下游芯片应用场景日益多元化,公司逐步推出定制化产品与一站式服务,根据客户工艺需求优化硅片技术参数,提供从产品研发、样品送样到批量供应的全流程服务,满足 AI、汽车电子、硅光等领域的差异化需求;在智能化生产方面,公司加速推进生产过程智能化升级,引入自动化控制系统、大数据分析等技术,优化晶体生长、切磨抛等核心工序的工艺参数,提升生产效率与产品一致性,提升对客户需求的响应速度;在全球化运营方面,公司采用“本土产能扩张 + 海外子公司深耕”的模式,一方面依托国内芯片制造企业的扩产红利,扩大本土产能规模,另一方面通过海外子公司拓展高端利基市场,完善全球化客户布局;在生态化布局方面,公司正逐步构建“硅片材料 – 芯片制造 – 终端应用”的全产业链生态,通过协同上下游企业,提升技术迭代能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,378,665.79	2,926,984.24	15.43	2,903,175.58
归属于上市公司股东的净资产	1,692,484.08	1,229,926.01	37.61	1,511,434.05
营业收入	371,603.01	338,761.17	9.69	319,030.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	367,918.63	332,889.15	10.52	318,823.89
利润总额	-188,851.99	-116,433.85	不适用	17,765.21
归属于上市公司股东的净利润	-150,750.66	-97,053.71	不适用	18,654.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,428.43	-124,306.16	不适用	-16,594.39
经营活动产生的现金流量净额	-55,923.98	-78,771.79	不适用	-27,472.74
加权平均净资产收益率(%)	-12.68	-7.07	不适用	1.27
基本每股收益(元/股)	-0.539	-0.353	不适用	0.068
稀释每股收益(元/股)	-0.539	-0.353	不适用	0.068
研发投入占营业收入的比例(%)	9.52	7.88	增加 1.64 个百分点	6.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	80,160.72	89,582.55	94,364.43	107,495.31
归属于上市公司股东的净利润	-20,852.85	-15,800.97	-26,474.18	-87,622.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,986.93	-23,116.50	-34,240.79	-95,084.21
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-29,535.32	-36,553.75	26,814.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	80,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,369
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	17.16	0	无	0	国有法人
上海国盛(集团)有限公司	0	546,000,000	16.52	0	无	0	国有法人
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	226,983,180	298,994,701	9.05	226,983,180	无	0	其他
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	-5,657,349	125,183,596	3.79	0	无	0	国有法人
上海新阳半导体材料股份有限公司	-10,588,320	111,546,975	3.38	3,410,283	无	0	境内非国有法人
海富产业投资基金管理有限公司-海富半导体创业投资(嘉兴)合伙企业(有限合伙)	104,489,404	104,489,404	3.16	104,489,404	无	0	其他
上海新微科技集团有限公司	-24,691,702	82,460,780	2.50	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	-31,891,185	74,763,920	2.26	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,410,515	71,391,502	2.16	20,887,570	无	0	其他
中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	46,623,551	46,623,551	1.41	46,623,551	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海硅产业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23沪硅 K1	240187	2028-11-17	13.4	3.17
上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24沪硅产业 MTN001	102484726	2029-10-31	5	2.68
上海硅产业集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	25沪硅产业 MTN001(科创票据)	102581788	2030-04-23	10	2.4

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海硅产业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	2025年度付息 4,247.80 万元
上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	2025年年度付息 1340 万元。
上海硅产业集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	未到期

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.33	34.4	5.93
扣除非经常性损益后净利润	-177,428.43	-124,306.16	不适用
EBITDA 全部债务比	-0.034	-0.005	不适用
利息保障倍数	-6.98	-5.32	不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 371,603.01 万元,较上年同期增长 9.69%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为 -150,750.66 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -177,428.43 万元。与上年同期相比,利润数据及相关财务指标受公司产能爬坡阶段固定成本投入高、尚未完全形成规模效应的影响,毛利承压的同时导致存货的跌价拟失厂较大。同时,受 200mm 及以下尺寸半导体硅片市场需求回升不及预期的影响,公司控股子公司新傲科技和 Okmetic 的业绩下滑,并导致公司在并购新傲科技和 Okmetic 时产生的商誉出现减值拟失,经测算,2025 年度公司计提商誉减值拟失约 4 亿元,对公司相关报告期的利润有较大影响。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-021

上海硅产业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等。

● 投资金额:人民币 250,000 万元

● 已履行的审议程序:上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额

公司拟使用额度不超过 250,000 万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。其中 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过 100,000 万元(包含本数),2025 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过 150,000 万元(包含本数)。

(三)资金来源

本次现金管理来源为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票及 2025 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金总结情况如下:

发行名称	2021年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2022年 2 月 17 日		
募集资金总额	499,999.99 万元		
募集资金净额	494,618.55 万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目	102.95	不适用
	300mm高端硅基材料研发中试项目	41.76	不适用
	补充流动性资金	100.07	不适用
是否影响募投项目实施	口是 √否		
发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间	2025年 12 月 17 日		
募集资金总额	210,500.00 万元		
募集资金净额	207,871.05 万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	补充流动资金	0	不适用
	支付本次交易的现金对价及中介机构费用	97.79	不适用
是否影响募投项目实施	口是 √否		

(四)投资方式

在授权期限内,公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等。

公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 160,000 万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下表所示:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金金额(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	260,000.00	260,000.00	1,337.50	0
2	普通大额存单	200,000.00	200,000.00	216.66	0
3	结构性存款	26,000.00	26,000.00	74.83	0
合计				1,628.99	0
最近 12 个月内单日最高投入金额		133,000.00			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		7.86			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)		-88.23			
募集资金总投资额度(万元)		160,000			
目前已使用的投资额度(万元)		0			
尚未使用的投资额度(万元)		160,000			

注 1:最近 12 个月截至目前指 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 15 日;

注 2:实际投入金额、实际收回本金为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额;

注 3:最近一年净资产、最近一年净利润为 2025 年度财务报表合并口径归母数据。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 250,000 万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐人国泰海通证券股份有限公司认为:公司本次使用向特定对象发行股票募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司本次使用向特定对象发行股票募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

经核查,独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人和独立财务顾问对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金